

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

公司于 2019 年 12 月 23 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次交易存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司 71.30% 的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组事项”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重组进展公告。

### 一、历史披露情况

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣邦股份，股票代码：300661）自 2019 年 12 月 9 日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-091）。公司股票停牌期间，每 5 个交易日发布一次停牌进展公告，于 2019

年 12 月 13 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌的进展公告》（公告编号：2019-092）。

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

公司于同日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-097）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 12 月 23 日（星期一）开市起复牌。

## 二、重组进展情况

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估工作尚未正式完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司本次重大资产重组尚需股东大会审议通过后，报中国证监会核准后予以实施。本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及最终获得中国证监会审批、核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日